

深圳市宏创捷电子有限公司

Shenzhen hongchuangjie Electronics Co., Ltd

客户名称:

Customer

/

产品名称:

Part Name

片式叠层大电流磁珠
Chip Beads For Power Line

产品规格:

Specification

HCBW Series

版本号:

Version No.

1.0

日期:

DATE

2020.11

制造 Manufacturer			客户 Customer		
拟制 Draft by	审核 Checked by	确认 Approve by	检验 Check by	审核 Checked by	批准 Approval by

请务必在使用敝公司产品之前阅读。

注意

■ 本产品目录中所记载的内容为2020年11月之内容。因改良等原因，可能会不经预告而变更记载内容，所以请务必在使用前先确认最新的产品信息。未按照本产品目录中所记载的内容或交货规格说明书使用敝公司产品的，即便其致使使用设备发生损害、瑕疵等时，敝公司也不承担任何责任，敬请悉知。

■ 就规格相关的详细内容，敝公司备有交货规格说明书，详情请向敝公司咨询。

■ 装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。

■ 请在采购规格书的范围内使用。

■ 使用敝公司产品时，请务必事先安装到设备之后，在实际使用的环境下进行评估和确认。

■ 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上的一般电子设备 [AV设备、办公自动化设备、家电产品、娱乐设备、办公设备、计测设备、信息/通讯设备（手机、电脑等）]。另外，请勿将敝公司产品使用于对安全性和可靠性要求较高的设备，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害（航天设备、航空设备、运输设备（汽车，电车，船舶等）、医疗设备、发电控制设备、原子能控制设备、核动力相关设备、海底设备、交通工具控制设备、公共性的高度信息处理设备、防灾设备、军事设备等）。且即便属于一般电子设备，使用于对安全性和可靠性要求较高的设备、电路上时，敝公司建议进行充分的安全评估，并根据需要，在设计时追加保护电路等。

未经敝公司的事先书面同意，把本产品目录中所记载的产品使用于前述需要向敝公司咨询的设备或敝公司禁止使用的设备，从而给客户或第三方造成损害的，敝公司不承担任何责任，敬请悉知。

■ 本产品目录中所记载的信息是用于说明相关产品的典型操作以及相关应用。此类信息的使用不代表对于敝公司以及第三方的知识产权以及其他权利的使用许可或是不侵权保证。

■ 敝公司产品的保证范围仅限于交付的敝公司产品单品，就敝公司产品的故障或瑕疵所诱发的损害，敝公司不承担任何责任，敬请悉知。

■ 本产品目录中所记载的内容适用于从敝公司营业所、销售子公司、销售代理店（即“正规销售渠道”）购买的敝公司产品，并不适用于从上述以外的渠道购买的敝公司产品，敬请悉知。

片式叠层磁珠—HCBW系列
Chip Beads For Power Line



特征

- 迭层独石结构、高度可靠性。
- 特别的设计可承受大电流。
- 在较宽的频段具有高阻抗。

FEATURES

- Monolithic Structure for high reliability.
- A unique terminal electrode structure ensures high permissible current.
- High impedance over a wide frequency range.

用途

- 视频音频设备。
- 通讯设备。
- OA设备及其它领域。

APPLICATIONS

- Video equipment, audio equipment.
- Communication equipment.
- OA equipment and other.

品名系统

PRODUCT IDENTIFICATION

HCBW 2012 - 121 T
① ② ③ ④

① 系列名称。

① Series name.

② 外形尺寸：1005=1.0mm*0.5mm
1608=1.6mm*0.8mm
2012=2.0mm*1.2mm
3216=3.2mm*1.6mm
3225=3.2mm*2.5mm

② External Dimensions :1005=1.0mm*0.5mm
1608=1.6mm*0.8mm
2012=2.0mm*1.2mm
3216=3.2mm*1.6mm
3225=3.2mm*2.5mm

③ 阻抗值：例如 000=0Ω
 300=30Ω
 121=120Ω
 601=600Ω

③ Impedance ;Eg. 000=0Ω
 300=30Ω
 121=120Ω
 601=600Ω

④ 包装形式：例如 B:散料
 T:卷带

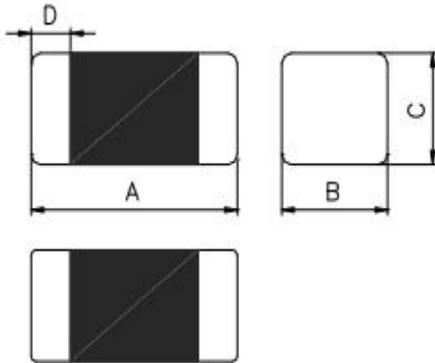
④ Packaging. B: Bulk material
 T: Winding tape

片式叠层磁珠—HCBW系列
Chip Beads For Power Line



外观尺寸

SHAPE AND DIMENSIONS



Unit: mm

Series	A	B	C	D
HCBW1005	1.0±0.15	0.5±0.15	0.5±0.15	0.25±0.1
HCBW1608	1.6±0.2	0.8±0.2	0.8±0.2	0.3±0.2
HCBW2012	2.0±0.2	1.2±0.2	0.9±0.2	0.5±0.3

规格特性

SPECIFICATIONS

HCBM1005 SERIES(TYPE)

PART NUMBER	Impedance (Ω)	DC Resistance (Ω)max	Test frequency	Rated current (mA)max
HCBW1005-000T	0~15Ω	0.04	100MHz	800
HCBW1005-050T	0~15Ω	0.04	100MHz	800
HCBW1005-070T	0~11Ω	0.04	100MHz	800
HCBW1005-090T	5~13Ω	0.04	100MHz	800
HCBW1005-110T	7~15Ω	0.04	100MHz	800
HCBW1005-150T	9~21Ω	0.04	100MHz	800
HCBW1005-190T	12~25Ω	0.06	100MHz	700
HCBW1005-260T	26Ω±25%	0.06	100MHz	700
HCBW1005-300T	30Ω±25%	0.08	100MHz	700
HCBW1005-600T	60Ω±25%	0.15	100MHz	600
HCBW1005-700T	70Ω±25%	0.2	100MHz	450
HCBW1005-800T	80Ω±25%	0.2	100MHz	450
HCBW1005-101T	100Ω±25%	0.2	100MHz	450
HCBW1005-121T	120Ω±25%	0.25	100MHz	450
HCBW1005-221T	220Ω±25%	0.4	100MHz	300
HCBW1005-301T	300Ω±25%	0.5	100MHz	300
HCBW1005-501T	500Ω±25%	0.65	100MHz	200
HCBW1005-601T	600Ω±25%	0.7	100MHz	200
HCBW1005-102T	1000Ω±25%	1	100MHz	200

片式叠层磁珠—HCBW系列
Chip Beads For Power Line



HCBM1608 SERIES(TYPE)

PART NUMBER	Impedance (Ω)	DC Resistance (Ω)max	Test frequency	Rated current (mA)max
HCBW1608-000T	0~15Ω	0.08	100MHz	1000
HCBW1608-110T	7~15Ω	0.08	100MHz	1000
HCBW1608-190T	12~25Ω	0.08	100MHz	1000
HCBW1608-300T	30Ω±25%	0.08	100MHz	1000
HCBW1608-500T	50Ω±25%	0.12	100MHz	1000
HCBW1608-600T	60Ω±25%	0.12	100MHz	1000
HCBW1608-800T	80Ω±25%	0.15	100MHz	1000
HCBW1608-101T	100Ω±25%	0.15	100MHz	1000
HCBW1608-121T	120Ω±25%	0.15	100MHz	1000
HCBW1608-151T	150Ω±25%	0.2	100MHz	1000
HCBW1608-181T	180Ω±25%	0.2	100MHz	1000
HCBW1608-221T	220Ω±25%	0.2	100MHz	1000
HCBW1608-301T	300Ω±25%	0.25	100MHz	1000
HCBW1608-501T	500Ω±25%	0.3	100MHz	1000
HCBW1608-601T	600Ω±25%	0.3	100MHz	1000
HCBW1608-801T	800Ω±25%	0.55	100MHz	500
HCBW1608-102T	1000Ω±25%	0.55	100MHz	500
HCBW1608-122T	1200Ω±25%	0.65	100MHz	500
HCBW1608-152T	1500Ω±25%	0.75	100MHz	400
HCBW1608-182T	1800Ω±25%	0.75	100MHz	400
HCBW1608-202T	2000Ω±25%	0.9	100MHz	400
HCBW1608-252T	2500Ω±25%	0.9	100MHz	400

HCBM2012 SERIES(TYPE)

PART NUMBER	Impedance (Ω)	DC Resistance (Ω)max	Test frequency	Rated current (mA)max
HCBW2012-000T	0~30Ω±25%	0.03	100MHz	3000
HCBW2012-110T	0~30Ω±25%	0.03	100MHz	3000
HCBW2012-300T	30Ω±25%	0.05	100MHz	3000
HCBW2012-600T	60Ω±25%	0.06	100MHz	3000
HCBW2012-800T	80Ω±25%	0.08	100MHz	2500
HCBW2012-101T	100Ω±25%	0.1	100MHz	2500
HCBW2012-121T	120Ω±25%	0.1	100MHz	2000

片式叠层大电流磁珠—HCBW系列
Chip Beads For Power Line



HCBW2012系列 (TYPE)

PART NUMBER	Impedance (Ω)	DC Resistance (Ω)max	Test frequency	Rated current (mA)max
HCBW2012-151T	150 Ω ±25%	0.1	100MHz	2000
HCBW2012-201T	200 Ω ±25%	0.15	100MHz	2000
HCBW2012-221T	220 Ω ±25%	0.15	100MHz	2000
HCBW2012-301T	300 Ω ±25%	0.2	100MHz	2000
HCBW2012-501T	500 Ω ±25%	0.25	100MHz	1500
HCBW2012-601T	600 Ω ±25%	0.25	100MHz	1500
HCBW2012-801T	800 Ω ±25%	0.3	100MHz	800
HCBW2012-102T	1000 Ω ±25%	0.3	100MHz	800
HCBW2012-152T	1500 Ω ±25%	0.5	100MHz	300
HCBW2012-202T	2000 Ω ±25%	0.5	100MHz	300
HCBW2012-222T	2200 Ω ±25%	0.6	100MHz	100
HCBW2012-252T	2500 Ω ±25%	0.6	100MHz	100

注意：HCBW整个系列

额定电流：是向线圈施加电流时，上升温度变化不得超过30。

记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

Rate Current : Applied the current to coils, the temperature rise shall not be more than 30

Please understand that the recorded contents may be improved and changed without notice.

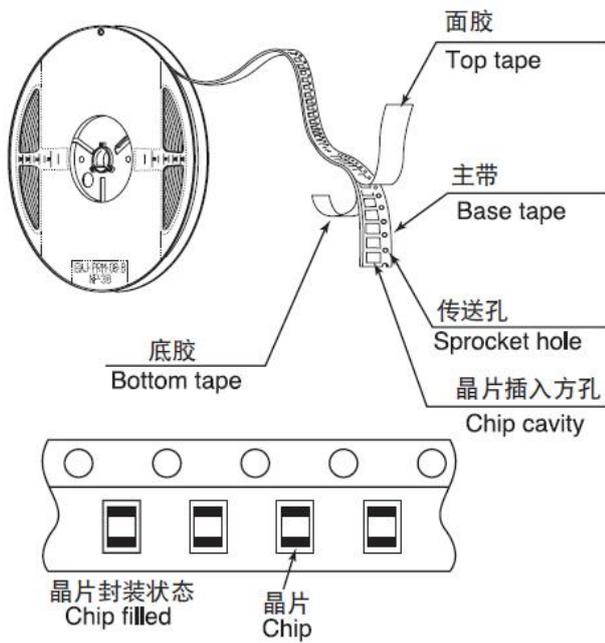
片式叠层大电流磁珠—HCBW系列
Chip Beads For Power Line



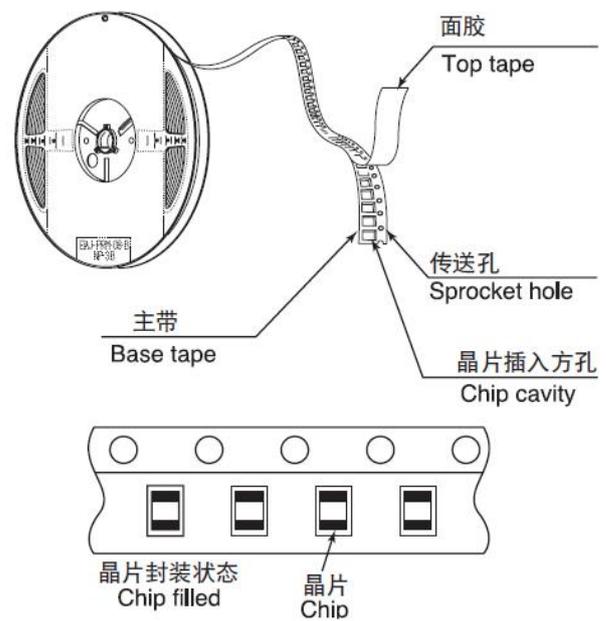
包装 PACKAGING

型号 TYPE	元件厚度 Thickness (mm)	标准数量 [pcs] Standard Quantity	
		纸带 Paper Tape	压纹带 Embossed Tape
HCBW1005	0.5	10000	
HCBW1608	0.8	4000	
HCBW2012	0.9	4000	

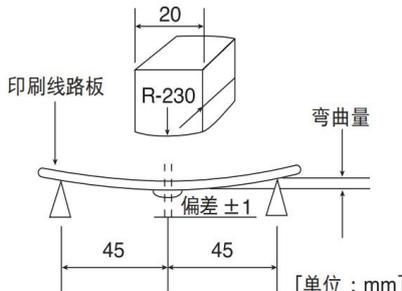
纸带
Card board carrier tape



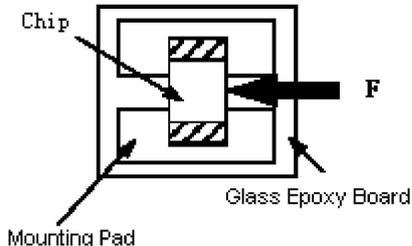
压纹带
Embossed Tape



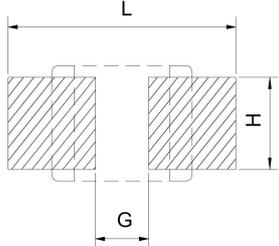
可靠性测试 RELIABILITY TESTING

项目	规格值	试验方法-摘要
1.使用温度范围	-40~+85°C	
2.保存温度范围	-10~+40°C	
3.电感值	参考标准电气特性列表	HP4291A, HP4287A+16092A
4.Q值		
5.直流电阻值		HP4338B
6.额定电流值		**
7.温升试验	30°C max. (ΔT)	1.施加允许的直流电流 2.用数字表面温度计测量的温度
8.抗弯曲强度	无机械损伤。 电感量变化率：±10%以内 品质因素变化率：±30%以内	弯曲量：2mm 试验线路板：玻璃基材、环氧树脂线路板 线路板厚度：0.8mm 
9.可焊性	75%以上的端子电极被新焊料覆盖。	焊锡温度：230±5°C 浸渍时间：4±1秒
10.焊接耐热性	无可见机械损伤。 端子电极残存率：70%以上 电感量变化率L、Q料： ±20%以内 S、T料：±30%以内 品质因素变化率小于±30%	焊锡温度：260±5°C 浸渍时间：10±0.5秒 预热温度：150~180°C 预热时间：2~3分 助焊剂：浸入包含松香的甲醇溶液中3~5秒钟 后期处理：试验后，在标准状态下放置2~3小时 如有疑问场合，请于标准状态下放置48±2小时再行测试

可靠性测试 RELIABILITY TESTING

项目	规格值	试验方法-摘要
11.端电极强度	端电极与磁体不应受损， 无可见机械损伤。	施加力：1005和1608系列为5N;2012、3216系列为10N；3225系列为15N 保持时间：10±1S 
12.跌落	无可见机械损伤。 电感量变化率：±10%以内 品质因素变化率：±30%以内	从高度为1米的空中自由落到混凝土地板重复10次。
13.振动	无可见机械损伤。 电感量变化率：±10%以内 品质因素变化率：±30%以内	振幅：1.5mm 测试时间：沿三个垂直方向各做2小时 测试频率：10Hz~55Hz~10Hz(1分钟)
14.耐低温	无可见机械损伤。 电感量变化率：±10%以内 品质因素变化率：±30%以内	测试温度：-40±2°C 试验时间：1000(+24/-0)小时 后期处理：从试验容器中取出后，在标准状态下放置2~3小时。 如有疑问场合，请于标准状态下放置48±2小时后再行测试

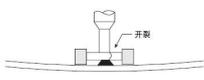
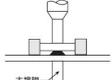
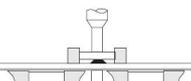
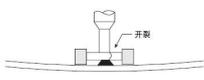
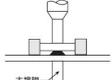
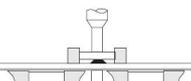
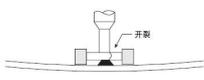
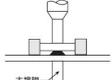
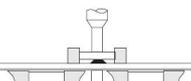
使用注意事项 CAUTION

工序名	注意事项	管理要点																								
1. 电路设计	<p>使用环境以及额定值・性能确认</p> <p>1. 消费类电子产品 工作电流（额定电流的确认）</p> <p>1. 电感器的电流应低于其额定电流值。 而且，存在直流电流与交流电流重叠的情况下，峰值电流之和应低于额定电流值。</p> <p>2. 由于磁饱和作用的影响电感值可能会下降，因此请勿使用超过额定电流值的工作电流。</p>																									
2. 印刷电路板设计	<p>安装定位设计 （焊盘图案设计）</p> <p>1. 安装电感器至印刷电路板时，焊垫尺寸和焊料的使用量（焊脚的尺寸）将直接影响电感器的性能。因此，必须慎重考虑以下项目。</p> <p>（1）若焊料使用量过多则作用于元件上的力将增加，从而可能导致破损及断裂等现象，因此在设计印刷电路板焊盘时，请设定适量焊料及其形状尺寸。</p> <p>（2）若有2个以上元件安装在相同焊盘上时，请使用阻焊剂分离各部分的焊接点。</p> <p>（3）焊盘尺寸大，焊料越多安装后Q值越小。</p>	<p>1. 根据如下所示的推荐焊盘尺寸、防止事例以及推荐事例以避免使用过多的焊料。</p> <p>（1）推荐焊盘之代表尺寸印刷电路板电极焊面相关</p>  <p>回流焊用推荐焊盘（单位mm）</p> <table border="1" data-bbox="922 1456 1500 1736"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>L (mm)</th> <th>G (mm)</th> <th>H (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1005</td> <td>2.1</td> <td>0.5</td> <td>0.55</td> </tr> <tr> <td>1608</td> <td>2.6</td> <td>0.6</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>3.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>3216</td> <td>4.4</td> <td>2.2</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>3225</td> <td>4.4</td> <td>2.2</td> <td>3.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>安装至印刷电路板后过多的焊料会影响电感器芯片的机械应力承受能，因此请慎重考虑焊面设计时的焊盘尺寸。</p>	型号	L (mm)	G (mm)	H (mm)	1005	2.1	0.5	0.55	1608	2.6	0.6	0.8	2012	3.0	1.0	1.0	3216	4.4	2.2	1.4	3225	4.4	2.2	3.4
型号	L (mm)	G (mm)	H (mm)																							
1005	2.1	0.5	0.55																							
1608	2.6	0.6	0.8																							
2012	3.0	1.0	1.0																							
3216	4.4	2.2	1.4																							
3225	4.4	2.2	3.4																							

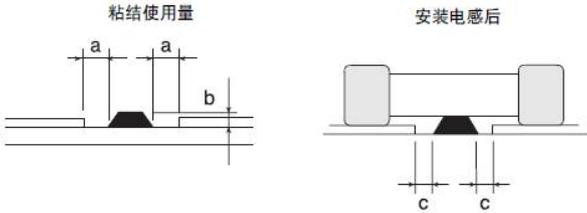
使用注意事项 CAUTION

工序名	注意事项	管理要点																					
2. 印刷电路板设计	<p>安装定位设计 (分割印刷线路板的电感器配置)</p> <p>1. 安装电感器至印刷电路板后, 在连续生产工序中(印刷电路板分割、线路板检测、其他部件安装、底盘组装、波峰焊与回流焊等等)或在操作过程中会产生印刷电路板弯曲、芯片破裂等情况, 因此请将电感器配置在印刷电路板弯曲时所受应力最小处。</p>	<p>(2) 防止事例或推荐事例</p> <table border="1" data-bbox="916 407 1506 833"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>防止事例</th> <th>推荐事例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>混合引线式元件</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>靠近底盘的元件配置</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>引线式元件后安装(手工焊接)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水平元件配置</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1-1. 印刷电路板反翘、弯曲时所受应力最小的电感器配置。</p> <table border="1" data-bbox="916 945 1506 1093"> <thead> <tr> <th></th> <th>防止事例</th> <th>推荐事例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>印刷电路板弯曲</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1-2. 靠近分割板处, 机械应力随电感器布局的变化而变化。请参照下图所示。</p> <div data-bbox="941 1265 1484 1635"> <p>应力大小 $A > B = C > D > E$</p> </div> <p>1-3. 分割印刷电路板时, 电感器所受机械应力的大小为: 推板 < 割裂 < V形凹槽 < 接缝孔。因此, 在配置电感器时必须同时考虑到印刷线路板的分割方法。</p>	项目	防止事例	推荐事例	混合引线式元件			靠近底盘的元件配置			引线式元件后安装(手工焊接)			水平元件配置				防止事例	推荐事例	印刷电路板弯曲		
		项目	防止事例	推荐事例																			
混合引线式元件																							
靠近底盘的元件配置																							
引线式元件后安装(手工焊接)																							
水平元件配置																							
	防止事例	推荐事例																					
印刷电路板弯曲																							

使用注意事项 CAUTION

工序名	注意事项	管理要点									
3. 自动装配	<p>调整贴片机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电感器自动安装至印刷线路板时，请避免设置过度冲击压力作用于本产品。 2. 请对贴片机进行定期保养及点检。 	<p>1. 吸拾管下限较低の場合在自动安装时，过度压力将作用于电感器从而导致其损坏。请参照下述要点。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 请调整吸拾管的下限至弯曲校正后印刷线路板的表面水平位置。 (2) 自动安装时，请设定喷嘴压力为1~3N。 (3) 为了减少吸拾管对印刷线路板的压力作用从而导致的线路板弯曲量，在线路板下方应使用支撑脚或挡块。请参照以下代表例。 <table border="1" data-bbox="917 887 1513 1155"> <thead> <tr> <th></th> <th>防止事例</th> <th>推荐事例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>单面安装</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>双面安装</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 由于定位爪磨损，因此在确定喷嘴高度时，将施加局部机械冲击应力于电感器上，导致电感器破碎、断裂。为了避免上述情况的发生，请确定停止位置定位爪之间的宽度，并定期执行定位爪的保养、点检及更新。</p>		防止事例	推荐事例	单面安装			双面安装		
	防止事例	推荐事例									
单面安装											
双面安装											

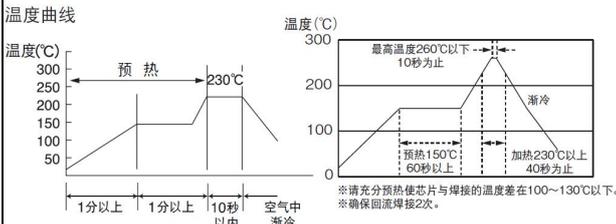
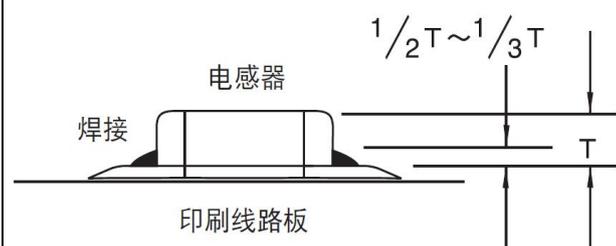
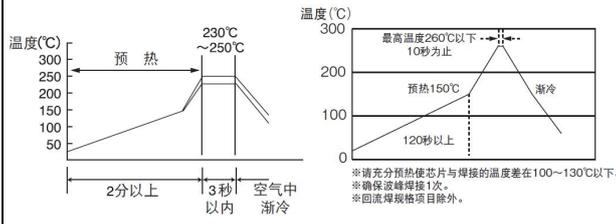
使用注意事项 CAUTION

工序名	注意事项	管理要点								
3. 自动装配	<p>选择粘合剂</p> <p>1. 正式焊接之前，电感器用粘合剂与印刷线路板固定，如果没有正确设置以下因素（焊盘尺寸、粘合剂种类、使用量、硬化程度、硬化时间等）则电感特性将可能会下降。因此，请务必询问粘合剂生产商的有关粘合剂的正确用法以及使用量。</p>	<p>1. 由于粘合剂和电感器之间的收缩率不同，将增加电感器所受到的收缩应力从而可能导致电感器断裂发生。粘合剂使用量过多或过少均会影响电感器的正确布局。请注意以下所述的各项要点。</p> <p>(1) 粘合剂的选择</p> <p>a. 粘合剂应具有足够强度保证贴片过程中元件不致脱落。</p> <p>b. 高温下粘合剂应具有足够强度。</p> <p>c. 粘合剂应具有良好涂层及厚度的保持性。</p> <p>d. 粘合剂应具有足够长的贮存期。</p> <p>e. 粘合剂应具有短时间内快速硬化的特性。</p> <p>f. 粘合剂应无腐蚀性。</p> <p>g. 粘合剂应具有良好绝缘特性。</p> <p>h. 粘合剂应无害且不会发出对人体有害气体。</p> <p>(2) 请参照下图所述的粘合剂的使用量。</p> <p>粘结印刷线路板和电感器时，粘合剂使用量的错误可能导致电感器脱落、超出焊盘范围等不良现象发生。</p> <p>(推荐条件)</p> <table border="1" data-bbox="922 1547 1509 1675"> <thead> <tr> <th>记号</th> <th>2012 事例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>0.3mm min</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>100 ~ 120μm</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>不要使粘合剂接触到焊盘</td> </tr> </tbody> </table> 	记号	2012 事例	a	0.3mm min	b	100 ~ 120 μ m	c	不要使粘合剂接触到焊盘
记号	2012 事例									
a	0.3mm min									
b	100 ~ 120 μ m									
c	不要使粘合剂接触到焊盘									

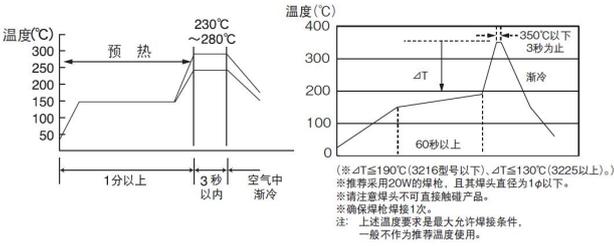
使用注意事项 CAUTION

工序名	注意事项	管理要点
4. 焊接	<p>助焊剂的选择</p> <p>1.由于助焊剂会对电感器的性能产生重要影响，因此请确认以下项目。</p> <p>（1）请使用松香类助焊剂，请勿使用强酸性助焊剂（氯含量超过0.2wt%的焊料）。</p> <p>（2）焊接电感器至印刷线路板时，请将助焊剂的使用量控制在最小限度。</p> <p>（3）请勿使用水溶性助焊剂。</p> <p>焊接</p> <p>1.请按照推荐温度、时间、焊料量条件执行操作。</p>	<p>1-1. 为使助焊剂活性化而添加的过多卤化物或强酸性物质在焊接后将产生较多残渣，从而导致端子电极腐蚀及电感器表面绝缘阻抗低下等现象产生。</p> <p>1-2. 波峰焊时，使用助焊剂将提高可焊性。但如果使用过多助焊剂，就会产生大量助焊剂废气，从而影响可焊性。</p> <p>为了控制助焊剂使用最小量，推荐采用发泡方式。</p> <p>1-3. 由于水溶性助焊剂残渣易溶于水性物质，则高湿环境下电感器表面的残渣可能导致其绝缘阻抗低下从而影响产品可靠性。因此，请勿使用水溶性助焊剂。</p> <p>1-1. 焊接时的预热</p> <p>请预热使电感器温度与焊接温度差为100~130℃以下。同时，焊接后清洗等急速冷却温度与电感器温度差不能超过100℃。</p> <p>电感器在急冷、急热或局部加热的情况下易于破损，焊接时请充分注意由于热冲击等所导致的产品故障。</p>

使用注意事项 CAUTION

工序名	注意事项	管理要点
4. 焊接	使用无铅焊接时，最高温度会有所变化，请与本公司联系确认。	<p>[焊接推荐条件][无铅焊接推荐条件][回流焊]</p> <p>温度曲线</p>  <p>温度(°C)</p> <p>300 250 200 150 100 50 0</p> <p>预热 230°C</p> <p>1分以上 1分以上 10秒以内 空气中渐冷</p> <p>温度(°C)</p> <p>300 200 100 0</p> <p>最高温度260°C以下 10秒为止</p> <p>预热150°C 60秒以上</p> <p>加热230°C以上 40秒为止</p> <p>渐冷</p> <p>※请充分预热磁芯片与焊接的温度差在100~130°C以下。 ※确保回流焊接2次。</p> <p>注意事项</p> <p>①理想的焊接高度（焊脚）应控制在如下所示电感器厚度的1/2~1/3之间。</p>  <p>电感器</p> <p>焊接</p> <p>印刷线路板</p> <p>$1/2T \sim 1/3T$</p> <p>T</p> <p>②请尽可能缩短焊接熔融时间。</p> <p>[波峰焊]</p> <p>温度曲线</p>  <p>温度(°C)</p> <p>300 250 200 150 100 50 0</p> <p>预热 230°C ~ 250°C</p> <p>2分以上 3秒以内 空气中渐冷</p> <p>温度(°C)</p> <p>300 200 100 0</p> <p>最高温度260°C以下 10秒为止</p> <p>预热150°C 120秒以上</p> <p>渐冷</p> <p>※请充分预热磁芯片与焊接的温度差在100~130°C以下。 ※确保波峰焊接1次。 ※回流规格项目除外。</p> <p>注意事项</p> <p>①请确定充分预热电感器。</p> <p>②请确认设定电感器与熔融焊料的温度差在100~130°C以下。</p> <p>③焊接后的冷却过程请尽可能处于渐冷状态。</p> <p>④波峰焊不能用于仅为回流焊设计的电感器。</p>

使用注意事项 CAUTION

工序名	注意事项	管理要点
4. 焊接	<p>使用无铅焊接时，最高温度会有所变化，请与本公司联系确认。</p>	<p>[焊枪焊接] 温度曲线</p>  <p>注意事项</p> <p>①推荐采用20W的焊枪，且其焊头直径为1φ以下。</p> <p>②焊头不可直接接触产品。</p>
5. 清洗	<p>印刷线路板清洗条件</p> <p>1. 电感器焊接后进行印刷线路板清洗时，请针对所使用的助焊剂以及清洗目的选择正确恰当的清洗液（如：去除焊接用助焊剂以及其他工序所沾染物质等）。 清洗温度：60℃以下（使用醇溶性清洗液时40℃以下）</p> <p>2. 清洗条件必须通过试验确认其清洗设备的清洗过程不影响电感器特性后再行决定。</p>	<p>1. 清洗液选择不恰当可能导致异物诸如助焊剂残渣等附着于电感器，从而使电感器性能劣化。</p> <p>2. 清洗条件不恰当（清洗不足，过度清洗）可能导致电感器性能受损。</p> <p>（1）过度清洗</p> <p>a. 超音波清洗条件下，过大功率输出可能导致印刷线路板过度震动从而使电感器本体及焊接部分断裂，或降低端子电极强度。因此请慎重考虑以下条件。</p> <p>超音波输出：20W / 1以下 超音波频率：40kHz以下 超音波清洗时间：5分钟以下 应注意不要使PCB和已安装产品产生谐振。</p>

使用注意事项 CAUTION

工序名	注意事项	管理要点
7.处理	<p>机械冲击</p> <p>1. 请注意避免使电感器受到任何过度的机械冲击。</p> <p>(1) 受到落下等过度冲击作用的产品不可使用。</p> <p>(2) 当处理已安装有电感器的印刷线路板时, 请避免使电感器触碰其他印刷线路板等元件。</p>	
8.储存·保管	<p>储存·保管</p> <p>1. 为防止包装材料以及外部电极受损, 请充分管理保存场所的温度和湿度条件, 尤其对于湿度条件, 请尽可能降低环境中的湿度条件。</p> <p>·请将本产品贮存于温度-10°C .. +40°C且湿度为70%RH以下的环境中(推荐环境温度为30°C以下)。</p> <p>不要将产品置于温度和湿度出现骤变的环境中。</p> <p>不要将产品保管于含有亚硫酸气或碱性气体之类的化学环境中。</p> <p>注意, 即使处于良好的保存环境下, 焊接特性也会随时间劣化。因此, 请于本公司发货后6个月以内使用。</p> <p>请在无卤素物质和硫磺等有害气体之处保管包装材料。</p> <p>远离潮湿和灰尘等。</p> <p>避免热冲击、振动、阳光直射等。</p>	<p>1. 保存于高温高湿环境下的产品, 会加速产生因电极端子发生氧化作用而导致焊接特性改变及包装材料劣化等性能问题, 因此推荐于6个月内使用。而且, 超过期限的产品, 请首先确认其焊接特性, 再行使用。</p>